FPCトータルソリューションサービス

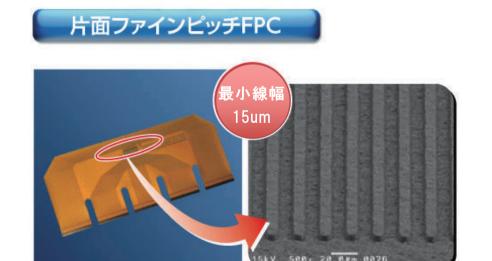


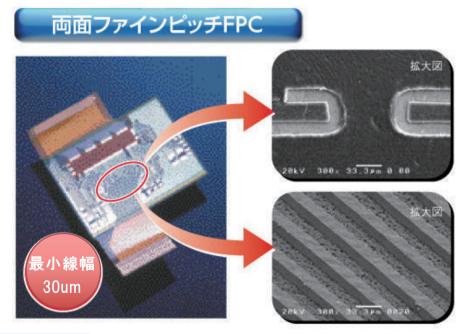
- ●材料調達から部品/チップ実装までを一貫して供給サポート
- ●豊富なコネクションにより最適な部材組み合わせをご提供
- ●ユーザー様のご要望に添ったカスタム装置のご提案

代表FPC(協力メーカーと対応)

ファインピッチ片面、両面FPC

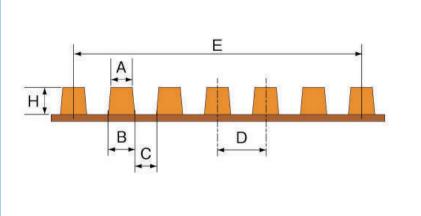
最小L/S=15/15um~、各種ディスプレイ接続、ディスプレイドライバ回路 接続での実績多数。





加工限界

		通常	ファイピッチ
A	線幅 (TOP)	Bに対し-30um	H=12um -10um H=6um -5um
В	線幅 (Bottom)	±30um 片面min 20um 両面min 35um	±20um 片面min 15um 両面min 30um
С	線間	片面min 20um 両面min 35um	片面min 15um 両面min 30um
D	ピッチ	片面min 40um 両面min 70um	片面min 30um 両面min 60um
Ε	トータルピッチ	±0.1%	要相談



【特長】

- ●各種ディスプレイ接続用●各種ディスプレイドライバ回路
- ●各種回路検査治具用 ●設計自由度の高い配線が可能
- ●素材がTABと比べ薄く、曲げ加工が容易

多層FPC 【仕様・構造】 ●**貫通VIA多層** 4層まで量産対応可能 ベースフィルム ベースフィルム ●ブラインドVIA多層〈スタガード〉 6層まで量産対応可能高密度化 薄膜化 BGA対応 カバーレイ ベースフィルム ベースフィルム ●ブラインドVIA多層〈スタック〉※開発中 レジスト ビアフィリング ベースフィルム ビア上に 階段状に ベースフィルム ビア形成 ビア形成

スタック

スタガード



ベースフィルム

レジスト